

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導體有限公司關於2025年前三季度計提資產減值準備的公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事會主席、總裁兼執行董事
白鵬先生

中國上海，二零二五年十一月六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

白鵬(董事會主席及總裁)

非執行董事：

葉峻
孫國棟
陳博
熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同
王桂壩 太平紳士
封松林

华虹半导体有限公司

关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 6 日审议通过了 2025 年前三季度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对上述资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。同时对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回。

公司本次计提信用减值损失 510.52 万元，计提资产减值损失 86,394.88 万元，转销资产减值损失 81,055.34 万元。计提及转销各项资产减值准备合计将减少公司 2025 年前三季度利润总额 5,850.06 万元。具体情况如下所示：

单位：人民币万元

序号	项目	计提金额	2025年前三季度减少金额		备注
			转回	转销	
1	信用减值损失	510.52	-	-	应收票据坏账、应收账款坏账损失
2	资产减值损失	86,394.88	-	81,055.34	存货跌价损失
合计		86,905.40	-	81,055.34	/

二、2025 年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年前三季度计提信用减值损失金额 510.52 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2025 年前三季度计提存货跌价损失金额 86,394.88 万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品已实现对外出售，2025 年前三季度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备 81,055.34 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司 2025 年前三季度利润总额 5,850.06 万元。公司本次计提、转回/转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日